

INFORMATIONEN

Erstellt von : **Anakonda Electronic Design**
 Brigitte Kielgas
 Ritterhufen 2A
 14165 Berlin
 Tel.: +49(0)30 834 90 58
 Mobil: +49(0)172 62 64 208
 Mail: info@anakonda.de

@@

Firma : DESY Zeuthen
 Lp.-Nr. : FBAP_1-9535-00
 Stand : 05.01.2023
 LP.-Mass : 425 mm x 128,7 mm x 2,0 mm
 Lagenzahl : 8

- Die Strukturen auf der Leiterplatte muessen den Strukturen in den Gerberdaten entsprechen.
- Der angegebene Lochdurchmesser im Bohrbild entspricht dem Endlochdurchmesser.

- **ACHTUNG!** Es werden folgende Steckverbinder mit **Press-fit** Verbindung verwendet:
 - o 3-5147490-2
 - o 10039755-10013TLF
 - o 10039755-10012TLF
 - o L17TF0902112
 - o 214782
- Die Datenblätter sind angehängt

FOTOPLOTT:
 Format : Gerber RS 274 X

BOHRFILE:
 Format : Excellon
 Masseinheit : metrisch

9535-00_L01T.ger Layer 1 - Top / Single-Ended 50 Ohm
 9535-00_L02i.ger Layer 2 - GND
 9535-00_L03i.ger Layer 3 - Diff-Pair 100 Ohm
 9535-00_L04i.ger Layer 4 - Power
 9535-00_L05i.ger Layer 5 - GND
 9535-00_L06i.ger Layer 6 - Diff-Pair 100 Ohm
 9535-00_L07i.ger Layer 7 - GND
 9535-00_L08B.ger Layer 8 - Bottom / Diff-Pair 90 Ohm
 9535-00_LSM1.ger Loetstopp Layer 1
 9535-00_LSM2.ger Loetstopp Layer 8
 9535-00_POS1.ger Best.-Druck Layer 1
 9535-00_POS2.ger Best.-Druck Layer 8
 9535-00_BOHR.ger Bohrbild

ThruHolePlated.ncd Bohrung DK
 ThruHoleNonPlated.ncd Bohrung NDK
 9535-00_Bohr.pdf Bohrbild

9535-00_Lagenaufbau_Diff-Pair.pdf Vorschlag-Lagenaufbau und Impedanzberechnung